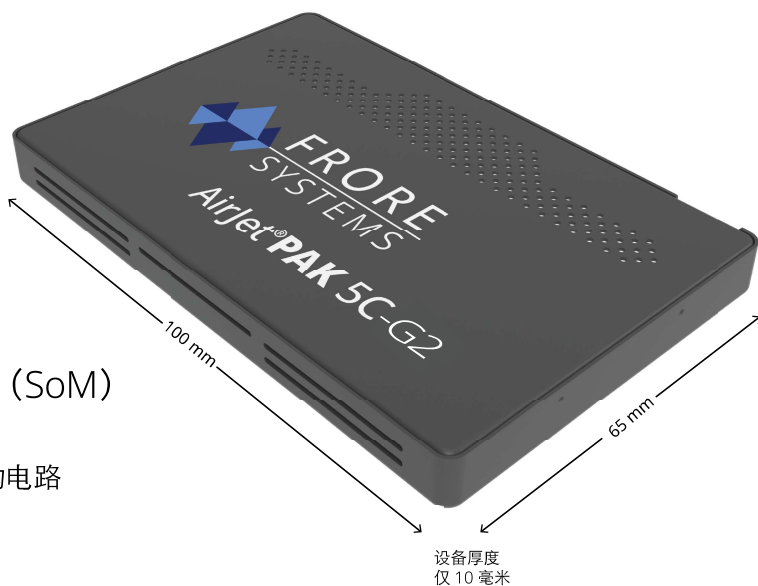




AirJet®PAK 5C-G2

为英伟达 Jetson Orin、Thor 等 AI 系统级模块（SoM）量身打造，释放 AI 性能

- 全集成、即插即用型散热方案，集成多枚 AirJet 芯片与驱动电路
- 直接安装于英伟达 Jetson Orin、Thor 等 AI SoM 模组
- 自主运行
- 超薄、静音、无振动、防尘、防溅水
- 可支持英伟达 Jetson 芯片输出 185 TOPS 算力
- 25°C环境温度下，散热功率达 45W，芯片结温（Tj）115°C



散热是计算领域最大的瓶颈，但散热却是现代计算中唯一仍沿用百年前技术的环节。AI 所需的大规模运算对散热性能的要求正快速提升，而据预测，到 2030 年边缘 AI 的需求将增长 300% 以上，这一趋势短期内不会放缓。

AirJet PAK 是全球首款面向边缘 AI 的固态主动散热方案，其核心是革命性的 AirJet 主动散热芯片。AirJet PAK 3C 是一款完全独立的主动散热模块。

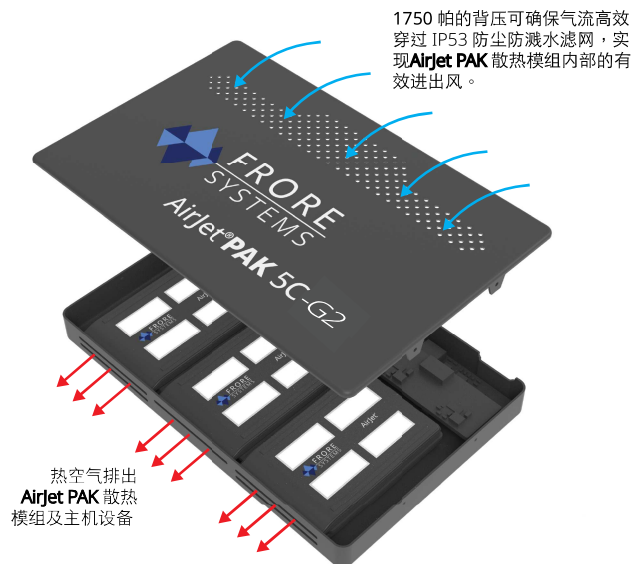
强劲散热能力 - AirJet PAK 5C-G2 在 25°C环境下集成至工业计算平台时，净散热功率达 45W，运行噪音仅 29 dBA，最大功耗 7.5W，在紧凑型边缘 AI 设备中性能优于风扇方案。

释放 AI 性能 - 专为英伟达 Jetson Orin 等 AI SoM 模块无缝适配而设计，AirJet PAK 5C-G2 厚度仅 10 毫米。这一超薄形态为制造商开辟了全新可能，助力其满足客户对更紧凑、静音、无振动、防尘且防水的高性能设备的需求。

NVIDIA Jetson	AirJet PAK	TOPS	Power
AGX Orin 32 GB (@ 环境温度25°C, 结温95°C)	AirJet PAK 5C-G2	185	37 W
AGX Thor 128 GB (@ 环境温度25°, 结温Tj 95°C)	2x AirJet PAK 5C-G2	400	74 W

每个 AirJet PAK 5C-G2 内置 5 枚 AirJet 芯片 - 全球首款固态主动散热芯片

参数	AirJet®PAK 5C-G2
净散热功率 (@ 环境温度25°C, 结温115°C)	45 W
最大噪音 (50cm距离)	29 dBA
最大功耗	7.5 W
输入电压	12 V
背压	1750 Pa
尺寸 (宽 x 长 x 厚度)	100 x 65 x 10 mm
重量	101 g



AirJet® PAK 5C-G2

持续性能与可靠性

AirJet PAK 可产生 1750 Pa 背压，即使通风口覆盖 IP53 防尘防溅水滤网，也能确保气流有效进出模块。这一设计最大化了可靠性，保障 **AirJet PAK** 的持续散热性能，进而实现防尘防溅水设备的持续高性能运行。

AirJet PAK 采用自主驱动，仅需主机设备提供标准电源，即可助力处理器实现卓越性能。

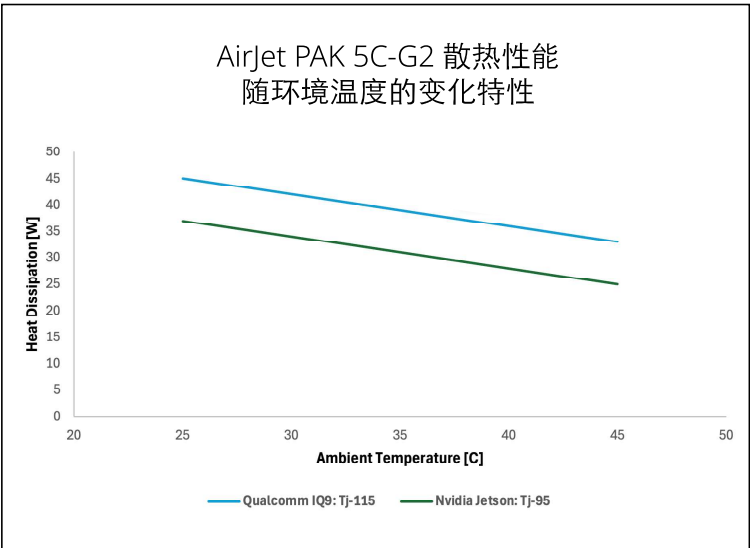
在如今的设备中，决定性能的往往是散热方案的能力，而非仅依赖处理器的先进性。

借助 **AirJet PAK 5C-G2**，紧凑型边缘 AI 电子设备如今可兑现尖端 AI 技术的性能承诺。实现更多。



AirJet PAK 通过
主机设备中应用板的
4 针 Molex PicoBlade
连接器供电

专为与英伟达 Jetson Orin 工业级模块、智能城市模块等 AI 系统级模块 (AI SoM) 实现无缝适配而设计



AirJet® PAK 模块在主机设备内的横截面

